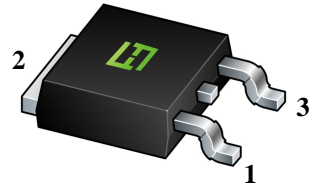
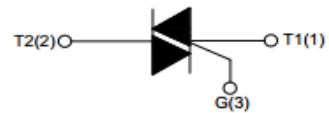


●产品特征:

NPNPN 五层结构的硅双向器件;
P 型对通扩散隔离;
台面玻璃钝化工艺;
背面多层金属电极;
工作结温高; 换向能力强;
高电压变化率 dV/dt ;
大电流变化率 dI/dt ;
符合 RoHS 规范.....



TO-252AB(DPAK)



T1:主端子 T2:主端子 G:触发极

应用:

加热控制器; 马达调速控制器; 麻将机; 搅拌机;
直发器; 面包机等家用电器等...

●主要参数:

符号	参数	数值	单位
$I_{T(RMS)}$	通态有效值电流	4	A
V_{DRM} / V_{RRM}	断态重复峰值电压	600/800	V
V_{TM}	导通压降	1.55	V

●极限参数 ($T_{CASE}=25^{\circ}C$):

符号	参数	条件	数值	单位
V_{DRM} / V_{RRM}	断态重复峰值电压	$T_j=25^{\circ}C$	600/800	V
$I_{T(RMS)}$	通态均方根电流	($T_C \leq 110^{\circ}C$), Fig. 1,2	4	A
I_{TSM}	通态不重复浪涌电流	全正弦波, $T_j(\text{init})=25^{\circ}C$, $tp=20ms$; Fig. 3,5	25	A
I^2t	I^2t 值	正弦波脉冲, $tp=10ms$	3.1	A^2s
dI_T/dt	通态电流临界上升率	$I_G=2 * I_{GT}$, $tr \leq 10ns$, $F=120Hz$, $T_j=125^{\circ}C$	I - II - III: 50 IV: 10	$A/\mu s$
I_{GM}	门极峰值电流	$tp=20\mu s$, $T_j=125^{\circ}C$	2	A
P_{GM}	门极峰值功率	$tp=20\mu s$, $T_j=125^{\circ}C$	5	W
$P_{G(AV)}$	门极平均功率	$T_j=125^{\circ}C$	0.5	W
T_{STG}	存储温度		-40—+150	$^{\circ}C$
T_j	工作结温		-40—+125	

●产品电性能

符号	参数	测试条件		数值		单位
				D	E	
I_{GT}	门极触发电流	$V_D=12V,$ $I_T=0.1A,$ $T_j=25^\circ C,$ Fig. 6	I - II - III	≤ 5	≤ 10	mA
			IV	≤ 10	≤ 25	
V_{GT}	门极触发电压	Fig. 6	I - II - III - IV	≤ 1.3		V
V_{GD}	门极不触发电压	$V_D=V_{DRM}, T_j=125^\circ C$		≥ 0.2		V
I_H	维持电流	$V_D=12V,$ $I_{GT}=0.1A,$ $T_j=25^\circ C,$ Fig. 6	I - II - III - IV	≤ 10	≤ 15	mA
I_L	擎住电流		I - III - IV	≤ 10	≤ 15	mA
			II	≤ 15	≤ 20	mA
dV_D/dt	断态电压临界上升率	$V_D=67\% V_{DRM},$ 门极开路 $T_j=125^\circ C$		≥ 10	≥ 20	V/ μs
V_{TM}	通态压降	$I_{TM}=6A, tp=380\mu s,$ Fig. 4		≤ 1.55		V
I_{DRM} / I_{RRM}	断态重复峰值电流	$V_D=V_{DRM}/V_{RRM}, T_j=25^\circ C$		≤ 5	≤ 5	μA
		$V_D=V_{DRM}/V_{RRM}, T_j=125^\circ C$		≤ 0.5	≤ 0.5	mA

●热阻:

符号	参数		数值	单位	
$R_{th(j-c)}$	结到管壳的热阻(AC)		TO-252AB	3.0	$^\circ C/W$
$R_{th(j-a)}$	结到环境的热阻	$S=0.5cm^2$	TO-252AB	70	$^\circ C/W$

●型号、标识说明:

<p>双向可控硅</p> <p>$I_{T(RMS)}=4A$</p> <p>TO-252AB</p>	<p>BT</p> <p>136</p> <p>D</p> <p>-600</p> <p>E</p>	<p>D: $I_{GT1-3} \leq 5mA, I_{GT4} \leq 10mA$</p> <p>E: $I_{GT1-3} \leq 10mA, I_{GT4} \leq 25mA$</p> <p>断态重复峰值电压</p> <p>600: $\geq 600V$</p> <p>800: $\geq 800V$</p>
--	---	--

● 参数特性曲线

FIG.1 最大功耗与均方根电流关系曲线图

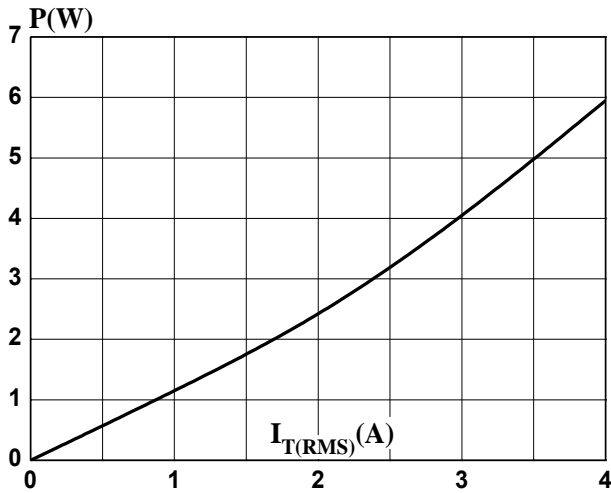


FIG.2:均方根电流与壳温关系曲线图

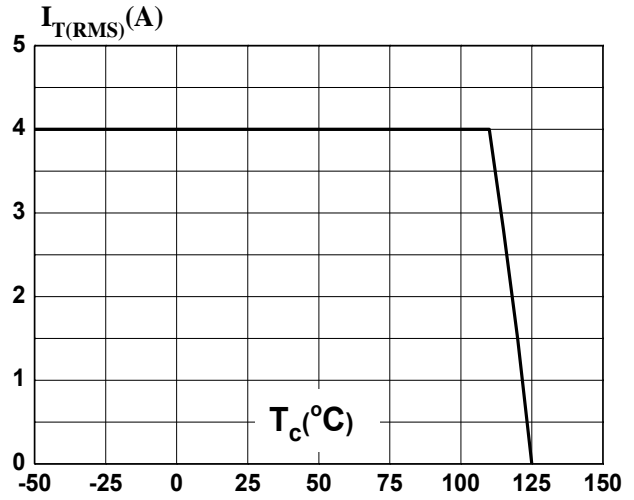


FIG.3: 峰值浪涌电流与周期数量关系图

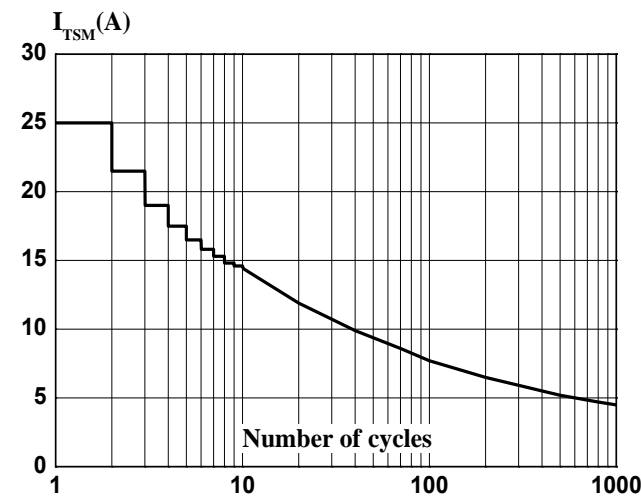


FIG.4: 输出特性图 (最大值图)

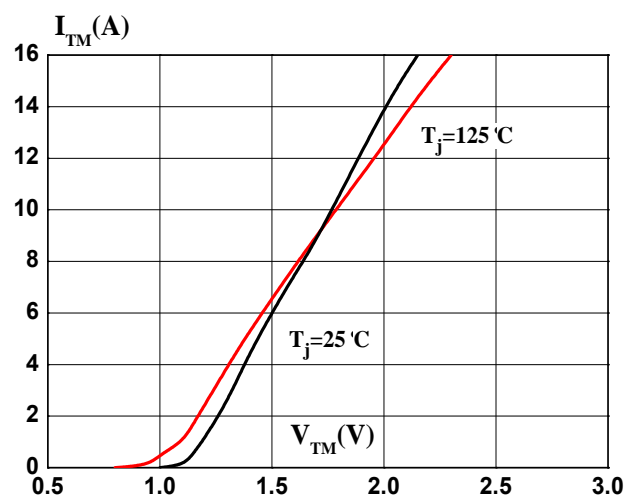


FIG.5: 非重复峰值浪涌电流与正弦波脉宽关系曲线

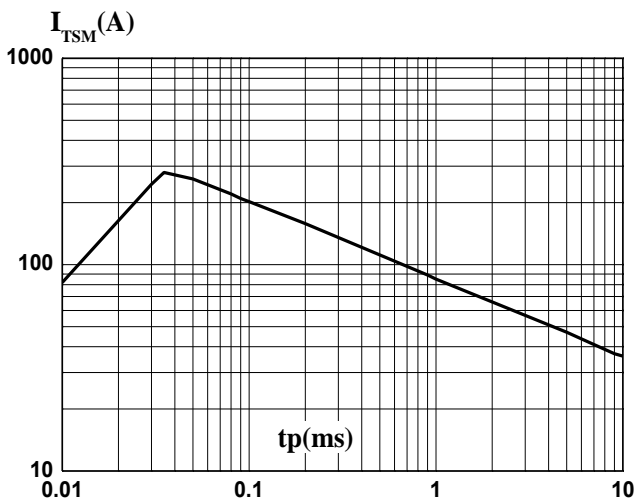
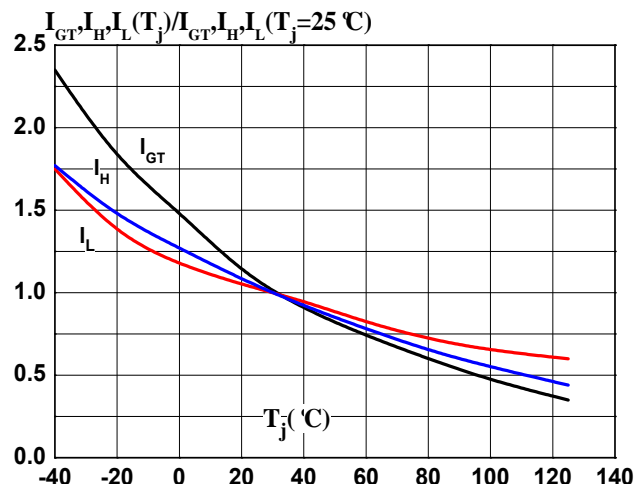


FIG.6: 门极触发电流、维持电流、擎住电流与结温关系曲线图



●封装外形尺寸

TO-252AB(DPAK)

